

「量子・AI ハイブリッド技術のサイバー・フィジカル開発事業」
実施予定先一覧

研究開発項目①: 量子・AI アプリケーション開発・実証

テーマ名	開発分野	実施予定先(五十音順)
量子・AI 支援による機能タンパク質最適化技術の研究開発	素材開発	国立大学法人東北大学 株式会社レボルカ (再委託先): 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (再委託先): 国立大学法人東京大学
量子生成AIによる半導体製造用新材料開発	素材開発	日本電気株式会社 (共同実施先): 国立研究開発法人産業技術総合研究所 (再委託先): 田中貴金属工業株式会社
量子+古典 AI による物流業務効率化のアプリケーション開発	物流・交通	大日本印刷株式会社 B I P R O G Y 株式会社 (再委託先): 株式会社エイファス
量子・AIによるポスト5G・6G用メタサーフェスデバイスの研究開発	製造	国立大学法人大阪大学 国立研究開発法人産業技術総合研究所 株式会社テクノプローブ
高次リサイクルシステム構築を志向する解体性接着技術開発	素材開発	アイカ工業株式会社 国立研究開発法人産業技術総合研究所 セメダイン株式会社 国立大学法人東京大学